

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项 目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目
- **投资金额：**计划总投资 15.57 亿元人民币（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次投资事项已经广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

本项目的实施需获得相关政府机关的立项、环评等备案或审批，以最终审批结果为准。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次项目新增产能规模较大且建设周期较长，在项目建设和经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化等风险，可能导致建设进度不及预期。本次项目所需资金较多，虽然公司目前资金较为充足且项目将分期实施，但仍可能面临资金筹措、利率水平等因素的不确定性风险。本项目在建设及经营过程中，若出现下游客户需求释放不及预期、行业竞争加剧等情况，则可能面临经营效益的不确定性风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将积极关注业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资概况

为抓住全球科技产业供应链重构机遇，加大高端产品布局，优化公司产品结构，提升在高端产品的竞争优势及市场占有率，公司拟投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目（以下简称“本项目”）。

本项目总投资 15.57 亿元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准），分两期项目实施，均由全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）在现有厂房投资建设，其中一期投资总额 6.28 亿元，建成后形成年产 34 万平方米高多层电路板的生产能力；二期投资总额 9.29 亿元，建成后将新增年产 26 万平方米高多层电路板的生产能力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	龙南骏亚电子科技有限公司；年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

2026年6月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资需提交公司股东会审议。

为保证本次投资有关事宜的有序、高效推进，董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次投资建设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表公司签署相关法律文件、组织实施该项目；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。

本项目尚需履行政府部门立项、环评等备案或审批手续。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次投资的对象为公司全资子公司龙南骏亚计划建设的年产60万平米高多层、HDI线路板项目。

(二) 投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产60万平米高多层、HDI线路板项目
项目主要内容	项目分两期开展建设，不涉及新增土地及基建，在龙南骏亚原有厂房内进行建设，拟进行厂房及配套设施装修、购置数控钻机、LDI曝光机、DES蚀刻线、镭射机、VCP线等各类生产及辅助设备，建成后合计形成年产60万平方米高多层PCB的生产能力（一期34万平方米、二期26万平方米产能）。
建设地点	江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
项目总投资金额（万元）	计划总投资155,729.16万元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）

上市公司投资金额（万元）	计划总投资 155,729.16 万元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）
项目建设期（月）	一期 24 月 二期 36 月
预计启动时间	2026 年第三季度
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、各主要投资方出资情况

本项目由龙南骏亚投资建设。

3、项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。

4、项目市场定位及可行性分析

（1）项目市场定位

当前，全球 PCB 产业正由规模扩张向结构优化转型，低端产品需求趋弱，高端化进程持续加速，其中高多层板、HDI 板已成为引领行业增长的核心品类。对公司而言，加快布局高多层板、HDI 板等高端产品，是实现增长曲线跃升的战略支点，也是在本轮产业变革中巩固竞争根基的必由之路。

从行业数据来看，高端 PCB 赛道景气度显著。据 Prismark 统计，2025 年高多层板、HDI 板产值同比增幅分别为 18.2%和 25.6%，均为 PCB 细分领域中增速领先品类；中长期看，2024-2029 年两者复合增长率预计分别达 9.0%和 11.2%，高端化发展趋势明确。

公司近两年在龙南基地孵化投入 HDI、高多层 PCB 的产品能力以及潜在客户。面对日益扩大的市场需求，公司现有产能已难以满足潜在客户规模化采购需求，亟需通过新建本项目，扩大生产能力。因此，公司根据行业的不断变化和市场需求投资新建高多层产线，推动公司产品结构升级，提升高端 PCB 的产品占比和市场占有率。

从公司现有产品结构来看，目前业务涵盖刚性电路板、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板、HDI 等多元化 PCB 产品，应用领域覆盖能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域等多个场景，但高附加值产品的营收占比仍有提升空间，产品结构有待进一步优化。本项目聚焦的高多层、HDI 产品，其生产制造涉及高阶 HDI 技术、高密度互连技术、高频高速信号传输技术等多项核心工艺，技术壁垒高，行业准入门槛高，相较于传统 PCB 产品，具有更高的技术附加值和产品单价。通过本项目的实施，公司将大幅扩大高端产品的生产规模，提高高附加值产品在整体营收中的占比，进一步优化产品结构，降低传统产品市场波动带来的经营风险，同时借助高端产品的高毛利特性，提升公司整体盈利水平和综合盈利能力。

（2）项目的可行性

自成立以来，公司发展规划始终聚焦于印制电路板（PCB）行业，业务涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板，产品结构类型丰富，兼具印制电路板研发、批量生产及整机服务能力，可以提供从样板到批量生产一站式服务，在技术领域形成了深厚的积累，这为公司向更高层次的高多层板业务拓展提供了坚实的技术支撑。为满足不同领域客户不同产品差异化的需求，公司积累了 HDI 板、厚铜板、光电板、Mini LED 板、高频高速板、软硬结合板、服务器板、光模块板等多项 PCB 生产核心技术。截至 2025 年末，公司已经取得授权专利 408 项，其中发明专利 102 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

本次扩产投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，满足新兴领域对高端 PCB 的中长期、高标准需求，具有良好的市场发展前景；扩充公司高多层 PCB 产品产能，完善专业化生产线，符合公司持续提升技术创新能力、优化产品结构和客户结构、聚焦核心赛道积极拓展高附加值订单的规划要求，有利于提高

公司经济效益，拓展公司经营规模。

（三）出资方式及相关情况

本次项目的建设资金来源为公司自有资金或银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设项目对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施具体情况确定。若本次公司子公司投资建设“年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目”能够顺利进行，将有助于进一步提高公司高多层电路板的生产规模、产品竞争力，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

四、对外投资的风险提示

1、宏观环境、市场需求不及预期及行业竞争加剧风险

本项目主要聚焦高附加值 PCB 产品，尽管公司对上述产品市场前景持乐观态度，但相关市场需求受宏观经济周期波动、行业竞争格局变化等多重因素影响，存在不确定性风险。若未来市场需求增长不及预期，同类产品的行业竞争加剧，可能导致产品价格下降、产能利用率不足，影响本项目的投资回报周期。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济、行业走势与客户需求情况变化等，结合实际情况，及时进行风险评估与应对。

2、本项目建设期延长、产能释放不及预期风险

本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。本项目的建设周期较长，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目建设存在延期、变更或终止风险；项目建设完成后，公司 PCB 产能进一步增大，若未来行业发展增速或市场需求出现重大不利变化、原材料价格出现大

幅波动等情况，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异，可能存在产能释放不及预期，进而对公司的经营业绩造成一定不利影响。

3、本项目资金需求较大，可能面临一定的资金风险

本项目计划总投资 15.57 亿元人民币，需要投入较多资金，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。截至 2026 年 3 月 31 日公司资产负债率 64.90%，资产负债率较高。若未来公司经营活动现金流不及预期、外部融资环境发生不利变化，可能面临一定的资金压力，将对项目的实施造成一定的不利影响。目前公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

4、经营管理风险

近年来，随着公司业务发展，公司产能和基地逐渐扩大，对公司在经营管理等方面的能力提出了更高的要求。本项目管理团队的组建或管理制度、流程创建与优化等也需要一定的过程。如果公司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、业务发展和管理复杂度提升的需求，将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力和发展活力，从而使公司面临相应的经营管理风险。

5、产品良率不稳定、产品质量风险及技术风险

本项目产品在量产过程中可能面临良率不稳定、生产效率不高等问题，影响项目盈利能力。同时，高端产品技术含量高，对生产工艺、设备精度及研发能力要求极高。若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势，可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化，产品竞争力下降。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026年6月23日